

【0050/東京・長岡】先端半導体パッケージ向けソフトウェアエンジニア　◆東証プライム上場 / 半導体・電子デバイスの最先端技術企…

> **ウシオ電機株式会社での募集です。 組み込み・制御系のご経験のある方は歓迎です。**

募集職種

人材紹介会社
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名
ウシオ電機株式会社

求人ID
1613887

業種
電気・電子・半導体

雇用形態
正社員

勤務地
東京都 23区

給与
500万円 ~ 900万円

勤務時間
08:45 ~ 17:15

休日・休暇
【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 年間有給休暇14日 ~ 23日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります） …

更新日
2026年10月29日 01:00

応募必要条件

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
ビジネス会話レベル

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
専門学校卒

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2410456】
~ 先端半導体パッケージ向けDLT装置のソフトウェア開発をご担当いただきます ~

DLT装置の仕様決定において、顧客の要求事項を整理し、標準機能での対応可否や実現方法を確認します。

対応できない要望については要求仕様としてまとめ、協業先と実現方法を協議しながら仕様へ反映します。
顧客への機能説明、協業先との技術調整、実装された機能の妥当性確認、営業・社内技術部門との連携などを担当します。
顧客との技術打ち合わせや国内外への出張もあります。

※ソフトウェアのコーディング・実装は担当しません。

■この仕事の魅力
・AI・HPC向け半導体を支える先端パッケージ用DLT事業に関われる
・顧客要求の整理から要件定義、仕様策定まで、ソフトウェア上流工程の経験を積める
・露光装置などの高度な生産設備に関する知識を身につけられる
・顧客や協業先の技術部門と連携し、グローバルなプロジェクトを推進できる
・ソフトウェアと装置・生産技術の知識を組み合わせ、技術の幅を広げられる
→顧客要求を整理し、生産設備として必要な要件・仕様を定義する上流工程が中心です。

スキル・資格

■必須要件
・ソフトウェアの要件定義、仕様策定、仕様決定などの上流工程経験3年以上
・顧客要求や関係者の要望を整理し、仕様書・要求事項としてまとめた経験
・ソフトウェアに関する基本的な知識
※ノーコードでの業務経験も含みますが、ソフトウェアの構造や仕様を理解できることを重視します
・英語での会話・読み書きに対応できる方
※TOEIC500点以上を目安とします
・技術的な内容について、英語で協業先と確認・調整できる方

■歓迎要件
・生産設備、製造装置、露光装置、精密機械、工作機械などに関する設計経験
・生産技術、設備技術、装置立上げなどの経験
・装置や設備における要求仕様・機能仕様の策定経験
・半導体製造装置、露光装置、アドバンストパッケージに関する知識
・顧客との技術折衝、要件定義、仕様変更管理の経験
・海外企業・海外技術部門との技術的な調整経験
・英語での技術会議、仕様書作成、メール対応の経験

会社説明

各種放電ランプ、ハロゲンランプ、レーザーなど光テクノロジーを利用した部品・装置の研究開発・製造